

放熱材料(プロセス別)

Heat dissipation materials (product line-up by process)

あらゆるプロセスに対応可能な製品をご提供します。

Provide suitable material for each process

ディスペンス

Dispense

シリコン接着剤：低アウトガス(低汚染)シリコン接着剤

Silicone adhesive: Low-out gas type

絶縁タイプ: KJR-9080シリーズ

Insulation type: KJR-9080 series

4W/mK以下

less than 4W/mK

導電タイプ: KJR-T200シリーズ

Electro conductive type: KJR-T200 series

30W/mK以下

less than 30W/mK

耐寒タイプ: KJR-9085シリーズ

Cold resistant type: KJR-9085 series

2W/mK以下(-70°Cまで使用可能)

less than 2W/mK (available by -70°C)

低温硬化タイプ: KJC-5080シリーズ

Low-temperature curing type: KJC-5080 series

3W/mK以下

less than 3W/mK



エポキシアンダーフィル材

Epoxy underfill material

SMC-375シリーズ

SMC-375 series

1.5W/mK以下

less than 1.5W/mK



印刷

Print

KJR-9080シリーズ(シリコン)

KJR-9080 series (silicone)

3.5W/mK以下

less than 3.5W/mK



コンプレッション成形

Compression mold

KJR-9080シリーズ(シリコン)

KJR-9080 series (silicone)

5W/mK以下

less than 5W/mK

SMC-762シリーズ(エポキシ)

SMC-762 series (epoxy)

2W/mK以下

less than 2W/mK



トランスファー成形

Transfer mold

KMC-4885シリーズ(エポキシ)

KMC-4885 series (epoxy)

5W/mK以下

less than 5W/mK



ラミネート

Laminate

SAHF-100シリーズ(シート)

SAHF-100 series (sheet)

30W/mK以下

less than 30W/mK

LPS-AF500シリーズ(フィルム)

LPS-AF500 series (film)

3W/mK以下

less than 3W/mK

LPS-AFSシリーズ(フィルム)

LPS-AFS series (film)

10W/mK以下

less than 10W/mK

